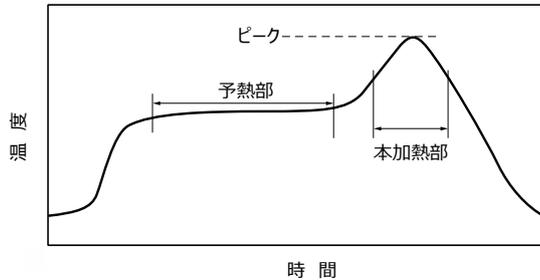


## 角形タイプの推奨はんだ付け条件

以下に、本製品の推奨はんだ付け条件に関する推奨条件及び注意事項を示します。

## ● リフローはんだ付け推奨条件

- ・リフローは 2 回まででご利用ください。
- ・保証温度を超える場合は、必ずご相談ください。
- ・基板及びはんだの種類毎に、製品端子部の温度及びはんだ付け性を予めご確認ください。



共晶はんだの場合 (Sn/Pb 系など)

	温度条件	時間
予熱部	140 °C ~ 160 °C	60 秒 ~ 120 秒
本加熱部	200 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
ピーク	235 ± 5 °C	10 秒以内

鉛フリーはんだの場合 (Sn/Ag/Cu 系など)

	温度条件	時間
予熱部	150 °C ~ 180 °C	60 秒 ~ 120 秒
本加熱部	230 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
ピーク	max. 260 °C	10 秒以内

## ● フローはんだ付け推奨条件

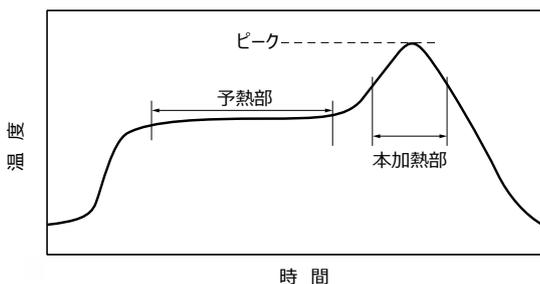
	共晶はんだの場合		鉛フリーはんだの場合	
	温度条件	時間	温度条件	時間
予熱部	140 °C ~ 160 °C	60 秒 ~ 120 秒	150 °C ~ 180 °C	60 秒 ~ 120 秒
はんだ付け	245 ± 5 °C	20 秒 ~ 30 秒	max. 260 °C	10 秒以内

## チップネットワーク形、チップ形アッテネータの推奨はんだ付け条件

以下に、本製品の推奨はんだ付け条件に関する推奨条件及び注意事項を示します。

## ● リフローはんだ付け推奨条件

- ・リフローは 2 回まででご利用ください。
- ・保証温度を超える場合は、必ずご相談ください。
- ・基板及びはんだの種類毎に、製品端子部の温度及びはんだ付け性を予めご確認ください。



共晶はんだの場合 (Sn/Pb 系など)

	温度条件	時間
予熱部	140 °C ~ 160 °C	60 秒 ~ 120 秒
本加熱部	200 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
ピーク	235 ± 5 °C	10 秒以内

鉛フリーはんだの場合 (Sn/Ag/Cu 系など)

	温度条件	時間
予熱部	150 °C ~ 180 °C	60 秒 ~ 120 秒
本加熱部	230 °C 以上	30 秒 ~ 40 秒
ピーク	max. 260 °C	10 秒以内

## ● フローはんだ付け

端子間ブリッジが発生する可能性が高いため、フローはんだは推奨致しかねます。  
EXBA タイプのフローはんだ付けについては、お問い合わせください。